

SFENG 1984年 000000 000 000 00 0000. 00, 00, 00, 000 0000 00 000000. ( 00 0000 0000 0000 00 ) 0000 00 0 00 0 000 0000, 0000 0000 0000 0000, 0000 00 00 0 00 000000 000000. 0000 00, 0000, 0000, 00, 00 0 00 00 00 0000 00 0000 00.

The image shows a technical drawing of the SF-P111-E probe. On the left, a vertical view shows the probe with dimensions: a 2.0mm diameter tip, a 6.3mm travel length, and a 33.3mm total length. The barrel has a diameter of 1.01mm. On the right, a grid of 15 tip options is shown, labeled -D, -A, -G, -E, -V, -B, -H, -U3, -T, -J, -LM, -U, and -B3. Each tip has specific geometric features like chamfers, chamfers with radii (e.g., R0.25), and chamfers with angles (e.g., 90°, 60°). A 7.0mm dimension is shown for the -B3 tip.

### 技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.90mm(.0748 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 1.35mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Full travel 行程	6.3(.2481 ")
Spring force 弹簧压力	120g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	3A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications  
Materials and finishes; Phosphor bronze,Gold plated

SF-P111-E

□□ □□	SF-□111
□□ □□ □□	1.90mm(.0748")
□□ □□ □□	□□□:1.35mm(.0532") □□□□□□, □□ □□ □□: 1.40mm(.0551")
□□ □□	6.30(.2481")
□□□□	120g
□□ □ □□□	□□□: Be Cu, Rh □□ □□ : □□, □□□ □□□ : □□□□□ □□
□□ □□□	3A
□□ □□	50mΩ
MOQ	100□
□□□□	□□□□ □□ □ □□□ □□ 7□

□□□ □□□

1. □□□ 24 □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.
2. □□□ □□□□ □□□□ OEM□ □□□□□.
3. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.
4. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

□□ □□

1. PCB, ICT, FCT □□□ □□ □□ □□□ □□ □(□□□);
  2. □□, □□ □□, □□□□, □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □(□□□□)
  3. BGA □ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□;
  4. □□□ □□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□□ LM □;
  5. □□□ □□□□, □□□ □□□□, □□□□□ □□;
  6. □□□ □ □□□ / □□;
  7. □□ □□ □□ □□, 30# OK □□□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □
- □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□!

□□□:





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



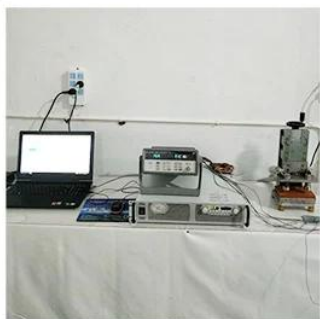
4. Quality inspection



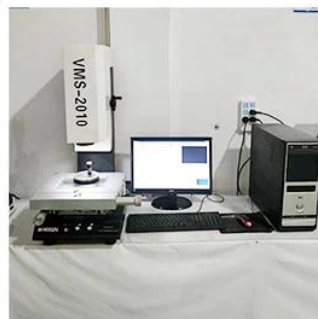
5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 如何選擇供應商?

A1: 選擇供應商, 應考慮其信譽、實力、價格、交貨期、服務等。

Q2. 如何進行品質管理?

A2: 品質管理 QC 應包括來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗, 並應建立品質管理體系。

Q3. 如何進行庫存管理?

A3: 庫存管理應包括庫存控制、庫存盤點、庫存分析等。

Q4. 如何進行採購管理?

A4: 採購管理應包括採購計劃、採購執行、採購評估等。

Q5. 如何進行合約管理?

A5: 合約管理應包括合約審核、合約執行、合約變更等。

Q6. 如何進行物流管理?

A6: 物流管理應包括運輸管理、倉庫管理、配送管理等。

Q7. OEM 與 ODM 有何區別?

A7: OEM 是原始設備製造商, ODM 是原始設計製造商。P 是採購商。

Q8. 如何進行風險管理?

A8: 風險管理應包括風險識別、風險評估、風險控制等。

如何選擇:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 等。

貿易條款: Exwork, FOB, CNF, CIF 等。



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe













CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司  
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

